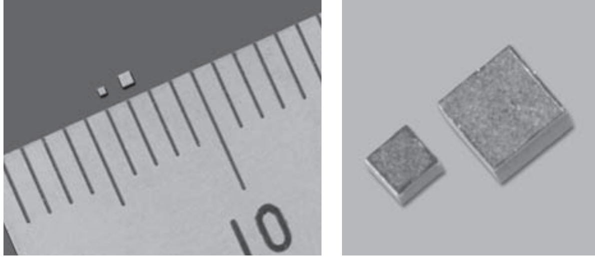
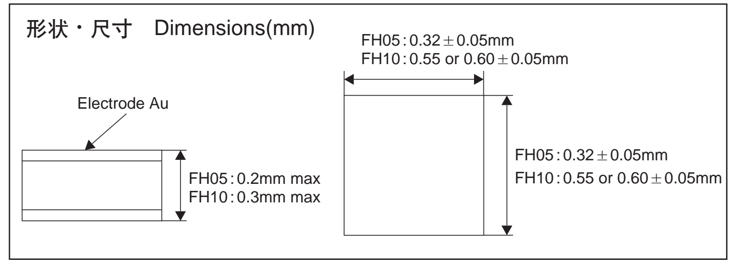
用于光通信模块 For Optical communication related equipment

FH05/10



FH05/10



■特点

●小型、高精度。
●可靠性持久。
●可焊性与粘合性优异。
●金锡焊接贴装时的稳定性优异。（约300℃）

■Features

●Small precision type
●Long-life Reliability
●Excellent solderability,bondability
●Excellent stability against Au/Sn soldering process(about 300℃)

■ FH05 系列 FH05series

FH05 系列（用于光通信模块） FH05Series (Optical communication related equipment)

型号（type）	使用温度范围 Temperature range	电阻值容许偏差（%） R25 Resistance tolerence at 25℃						B值容许偏差 B25/50（%） B value tolerence					电阻值 R25 resistance	B值 B25/50 B value	B值 B25/85 B value	最大功率（mW） Maximum power dissipation	散热系数（mW/℃） Heat dissipation
6D103＊C	−40～+125℃		±1	±2	±3				±1				10kΩ	3,930K	3,941K	15	0.15

■ FH10 系列 FH10series

FH10 系列（用于光通信模块） FH10Series (Optical communication related equipment)

型号（type）	使用温度范围 Temperature range	电阻值容许偏差（%） R25 Resistance tolerence at 25℃						B值容许偏差 B25/50（%） B value tolerence					电阻值 R25 resistance	B值 B25/50 B value	B值 B25/85 B value	最大功率（mW） Maximum power dissipation	散热系数（mW/℃） Heat dissipation
6E103＊C	−40～+125℃		±1	±2	±3				±1				10kΩ	3,950K	4,000K	30	0.3
6Q103＊C			±1	±2	±3				±1				10kΩ	3,410K	3,455K		
3U104＊C			±1	±2	±3				±1				15kΩ	3,950K	4,024K		

■推荐焊接条件 Recommended Soldering Profile

FH 系列 Au/Sn 焊接安装 FH Series Au/Sn Solder mounting
焊接：Au/Sn（79/21）预制 Solder：Au/Sn（79/21）Preform
安装设备：芯片焊接机 Mounting device : Die bonder
N_2 流量：3L/min N_2 flow : 3L/min
安装温度：320℃ Mounting Temperature : 320℃
1）超过 280℃的温度应控制在 10 秒以内。 1) Please keep exposure to temperature exceeding 280℃ to under 10seconds.
2）焊接后切勿迅速冷却，而应缓慢冷却。 2) After soldering, do not force cool,allow the parts to cool gradually.